



# Transfer Molding System

Model YLC2200



**Chinese version system of the "YPM series"  
enabling high-quality molding**

# 可实现高品质成形的 YPM系列中国版设备

- 改良后的YPM系列旗舰注塑成形设备，以满足中国市场需求
- 可对应100×300mm尺寸的框架
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



## SPECIFICATION

Items		Unit	Description				
机型		—	YLC2200				
框架·基板类型		—	引线框架				
框架·基板尺寸	长度	mm	150—300				
	宽度	mm	35—100				
树脂	径	mm	φ13, 14, 16, 18, 20				
	长度	mm	14.3—35.0				
机械时间		sec	Approximately 25				
外形尺寸	模组数量	module	1	2	3	4	
	堆叠式收料方式	宽度	mm	2,560	3,260	3,960	4,660
		纵深	mm	1,600	1,600	1,600	1,600
		高度	mm	1,980	1,980	1,980	1,980
	插片式收料方式	宽度	mm	2,560	3,260	3,960	4,660
		纵深	mm	2,050	2,050	2,050	2,050
高度		mm	1,980	1,980	1,980	1,980	
重量	堆叠式收料方式	ton	6.1	9.6	13.1	16.6	
	插片式收料方式	ton	6.4	9.9	13.4	16.9	
每模成形框架数量		workpiece	2	4	6	8	
进料盒空间		mm	550				
出料盒数量(堆叠式收料方式)		pcs	2				
出料盒空间(插片式收料方式)		mm	440				
合模压力		kN/(tf)	490.0—1,960.0/50.0—200.0				
注塑压力		kN/(tf)	3.92—49.0/0.4—5.0				
品种切换方式		—	采用KIT更换方式				
可以安装的模具		—	2XL				

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商



[ 东和半导体设备（上海）有限公司 ]

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

TEL 021-6888-6860

### [ Overseas Sales Contacts ]

#### ■ Japan / Headquarters

- TOWA Corporation

#### ■ China

- TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
- Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
- TOWA Taiwan Co., Ltd.

#### ■ Korea

- TOWA Korea Co., Ltd.

#### ■ Singapore

- TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

#### ■ Malaysia

- TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

#### ■ Thailand

- TOWA THAI COMPANY LIMITED

#### ■ Philippines

- TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

#### ■ India

- TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

#### ■ Germany

- TOWA Europe GmbH

#### ■ Netherlands

- TOWA Europe B.V.

#### ■ the United States

- TOWA USA Corporation

